

# 2022-2028年中国芯片行业 发展态势与市场年度调研报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2022-2028年中国芯片行业发展态势与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202205/295133.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

芯片（半导体元件产品的统称），集成电路，缩写为 IC；或称微电路、微芯片、晶片/芯片在电子学中是一种将电路（主要包括半导体设备，也包括被动组件等）小型化的方式，并时常制造在半导体晶圆表面上。

中企顾问网发布的《2022-2028年中国芯片行业发展态势与市场年度调研报告》共十三章。首先介绍了芯片行业市场发展环境、芯片整体运行态势等，接着分析了芯片行业市场运行的现状，然后介绍了芯片市场竞争格局。随后，报告对芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片产业有个系统的了解或者想投资芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 芯片行业的总体概述

#### 1.1 基本概念

#### 1.2 制作过程

##### 1.2.1 原料晶圆

##### 1.2.2 晶圆涂膜

##### 1.2.3 光刻显影

##### 1.2.4 掺杂杂质

##### 1.2.5 晶圆测试

##### 1.2.6 芯片封装

##### 1.2.7 测试包装

### 第二章 2016-2020年全球芯片产业发展分析

#### 2.1 2016-2020年世界芯片市场综述

##### 2.1.1 市场特点分析

##### 2.1.2 全球市场规模

##### 2.1.3 市场竞争格局

## 2.2 2016-2020年美国芯片产业分析

### 2.2.1 市场发展格局

### 2.2.2 行业并购情况

### 2.2.3 类脑芯片发展

### 2.2.4 技术研发动态

## 2.3 2016-2020年日本芯片产业分析

### 2.3.1 产业订单规模

### 2.3.2 技术研发进展

### 2.3.3 芯片工厂布局

### 2.3.4 日本产业模式

### 2.3.5 产业投资动态

## 2.4 2016-2020年韩国芯片产业分析

### 2.4.1 产业发展阶段

### 2.4.2 市场格局分析

### 2.4.3 市场发展规模

### 2.4.4 市场发展战略

## 2.5 2016-2020年印度芯片产业分析

### 2.5.1 芯片设计发展形势

### 2.5.2 产业发展困境分析

### 2.5.3 产业发展对策分析

### 2.5.4 未来发展机遇分析

## 2.6 其他国家芯片产业发展分析

### 2.6.1 英国

### 2.6.2 德国

## 第三章 2016-2020年中国芯片产业发展环境分析

### 3.1 政策环境分析

#### 3.1.1 智能制造政策

#### 3.1.2 集成电路政策

#### 3.1.3 智能传感器政策

#### 3.1.4 “互联网+”政策

### 3.2 经济环境分析

- 3.2.1 国民经济运行状况
- 3.2.2 工业经济增长情况
- 3.2.3 固定资产投资情况
- 3.2.4 经济转型升级形势
- 3.2.5 宏观经济发展趋势
- 3.3 社会环境分析
  - 3.3.1 互联网加速发展
  - 3.3.2 智能芯片不断发展
  - 3.3.3 科技人才队伍壮大
  - 3.3.4 万物互联带来需求
- 3.4 技术环境分析
  - 3.4.1 技术研发进展
  - 3.4.2 无线芯片技术
  - 3.4.3 技术发展方向

## 第四章 2016-2020年年中国芯片所属产业发展分析

- 4.1 2016-2020年中国芯片产业发展状况
  - 4.1.1 产业发展背景
  - 4.1.2 产业发展意义
  - 4.1.3 产业发展成就
  - 4.1.4 产业发展规模
  - 4.1.5 产业加速发展
  - 4.1.6 产业发展契机
- 4.2 2016-2020年中国芯片市场格局分析
  - 4.2.1 厂商经营现状
  - 4.2.2 区域布局状况
  - 4.2.3 市场发展形势
- 4.3 2016-2020年中国量子芯片发展进程
  - 4.3.1 产品发展历程
  - 4.3.2 市场发展形势
  - 4.3.3 产品研发动态
  - 4.3.4 未来发展前景

## 4.4 2016-2020年芯片产业区域发展动态

### 4.4.1 湖南

### 4.4.2 上海

### 4.4.3 北京

### 4.4.4 深圳

### 4.4.5 晋江

### 4.4.6 西安

## 4.5 中国芯片产业发展困境分析

### 4.5.1 市场垄断困境

### 4.5.2 过度依赖进口

### 4.5.3 技术短板问题

## 4.6 中国芯片产业应对策略分析

### 4.6.1 突破垄断策略

### 4.6.2 产业发展对策

### 4.6.3 加强技术研发

## 第五章 2016-2020年中国芯片产业上游市场发展分析

### 5.1 2016-2020年中国半导体产业发展分析

#### 5.1.1 产业链结构

#### 5.1.2 行业发展意义

#### 5.1.3 产业发展基础

#### 5.1.4 产业发展态势

#### 5.1.5 产业规模现状

#### 5.1.6 产业投资基金

### 5.2 2016-2020年中国芯片设计行业发展分析

#### 5.2.1 产业发展历程

#### 5.2.2 市场发展现状

#### 5.2.3 市场销售规模

#### 5.2.4 产业区域分布

### 5.3 2016-2020年中国晶圆代工产业发展分析

#### 5.3.1 晶圆加工技术

#### 5.3.2 晶圆制造工艺

- 5.3.3 晶圆工厂分布
- 5.3.4 企业竞争现状
- 5.3.5 行业发展展望

## 第六章 芯片行业重点企业经营分析

- 6.1 高通 (Qualcomm)
  - 6.1.1 企业发展简况分析
  - 6.1.2 企业经营情况分析
  - 6.1.3 企业经营优劣势分析
- 6.2 博通有限公司
  - 6.2.1 企业发展简况分析
  - 6.2.2 企业经营情况分析
  - 6.2.3 企业经营优劣势分析
- 6.3 英伟达 (NVIDIA Corporation)
  - 6.3.1 企业发展简况分析
  - 6.3.2 企业经营情况分析
  - 6.3.3 企业经营优劣势分析
- 6.4 美国超微公司 (AMD)
  - 6.4.1 企业发展简况分析
  - 6.4.2 企业经营情况分析
  - 6.4.3 企业经营优劣势分析
- 6.5 Marvell
  - 6.5.1 企业发展简况分析
  - 6.5.2 企业经营情况分析
  - 6.5.3 企业经营优劣势分析
- 6.6 赛灵思 (Xilinx)
  - 6.6.1 企业发展简况分析
  - 6.6.2 企业经营情况分析
  - 6.6.3 企业经营优劣势分析
- 6.7 Cirrus logic
  - 6.7.1 企业发展简况分析
  - 6.7.2 企业经营情况分析

### 6.7.3 企业经营优劣势分析

## 6.8 联发科

### 6.8.1 企业发展简况分析

### 6.8.2 企业经营情况分析

### 6.8.3 企业经营优劣势分析

## 6.9 展讯

### 6.9.1 企业发展简况分析

### 6.9.2 企业经营情况分析

### 6.9.3 企业经营优劣势分析

## 6.10 其他企业

### 6.10.1 海思

### 6.10.2 瑞星

### 6.10.3 Dialog

## 第七章 晶圆代工行业重点企业经营分析

### 7.1 格罗方德

#### 7.1.1 企业发展概况

#### 7.1.2 经营状况

### 7.2 三星（Samsung）

#### 7.2.1 企业发展概况

#### 7.2.2 经营状况

### 7.3 Tower jazz

#### 7.3.1 企业发展概况

#### 7.3.2 经营状况

### 7.4 富士通

#### 7.4.1 企业发展概况

#### 7.4.2 经营状况

### 7.5 台积电

#### 7.5.1 企业发展概况

#### 7.5.2 经营状况

### 7.6 联电

#### 7.6.1 企业发展概况

## 7.6.2 经营状况

## 7.7 力晶

### 7.7.1 企业发展概况

### 7.7.2 经营状况

## 7.8 中芯

### 7.8.1 企业发展概况

### 7.8.2 经营状况

## 7.9 华虹

### 7.9.1 企业发展概况

### 7.9.2 经营状况

## 第八章 2016-2020年中国芯片产业中游市场发展分析

### 8.1 2016-2020年中国芯片封装行业发展分析

#### 8.1.1 封装技术介绍

#### 8.1.2 市场发展现状

#### 8.1.3 国内竞争格局

#### 8.1.4 技术发展趋势

### 8.2 2016-2020年中国芯片测试行业发展分析

#### 8.2.1 芯片测试原理

#### 8.2.2 测试准备规划

#### 8.2.3 主要测试分类

#### 8.2.4 发展面临的问题

### 8.3 中国芯片封测行业发展方向分析

#### 8.3.1 行业发展机遇

#### 8.3.2 集中度持续提升

#### 8.3.3 产业竞争加剧

#### 8.3.4 产业短板补齐升级

## 第九章 芯片封装测试行业重点企业经营分析

### 9.1 Amkor

#### 9.1.1 企业发展概况

#### 9.1.2 经营状况

- 9.2 日月光
  - 9.2.1 企业发展概况
  - 9.2.2 经营状况
- 9.3 矽品
  - 9.3.1 企业发展概况
  - 9.3.2 经营状况
- 9.4 南茂
  - 9.4.1 企业发展概况
  - 9.4.2 经营状况
- 9.5 长电科技
  - 9.5.1 企业发展概况
  - 9.5.2 经营状况
- 9.6 天水华天
  - 9.6.1 企业发展概况
  - 9.6.2 经营状况
- 9.7 通富微电
  - 9.7.1 企业发展概况
  - 9.7.2 经营状况
- 9.8 士兰微
  - 9.8.1 企业发展概况
  - 9.8.2 经营状况
- 9.9 其他企业
  - 9.9.1 颀邦
  - 9.9.2 UTAC
  - 9.9.3 J-Device

## 第十章 2016-2020年中国芯片产业下游应用市场发展分析

- 10.1 LED
  - 10.1.1 芯片产值规模
  - 10.1.2 企业发展动态
  - 10.1.3 封装技术难点
  - 10.1.4 行业规模预测

- 10.1.5 LED产业趋势
- 10.2 物联网
  - 10.2.1 产业链的地位
  - 10.2.2 市场发展状况
  - 10.2.3 细分市场规模
  - 10.2.4 物联网wifi芯片
  - 10.2.5 国产化的困境
  - 10.2.6 产业发展困境
- 10.3 无人机
  - 10.3.1 无人机产业链
  - 10.3.2 中国市场规模
  - 10.3.3 市场竞争格局
  - 10.3.4 主流主控芯片
  - 10.3.5 芯片应用领域
  - 10.3.6 市场前景趋势
- 10.4 北斗系统
  - 10.4.1 北斗芯片概述
  - 10.4.2 产业发展态势
  - 10.4.3 芯片产销状况
  - 10.4.4 芯片研发进展
  - 10.4.5 资本助力发展
  - 10.4.6 产业发展趋势
- 10.5 智能穿戴
  - 10.5.1 行业发展规模
  - 10.5.2 市场竞争格局
  - 10.5.3 核心应用芯片
  - 10.5.4 芯片厂商对比
  - 10.5.5 行业发展方向
  - 10.5.6 商业模式探索
- 10.6 智能手机
  - 10.6.1 市场发展状况
  - 10.6.2 手机芯片销量

- 10.6.3 无线充电芯片
- 10.6.4 市场竞争格局
- 10.6.5 产品性能情况
- 10.7 汽车电子
  - 10.7.1 行业发展状况
  - 10.7.2 芯片制造标准
  - 10.7.3 车用芯片市场
  - 10.7.4 车用芯片格局
  - 10.7.5 汽车电子渗透率
  - 10.7.6 未来发展前景
- 10.8 生物医药
  - 10.8.1 基因芯片介绍
  - 10.8.2 主要技术流程
  - 10.8.3 技术应用情况
  - 10.8.4 重点企业分析
  - 10.8.5 生物研究的应用
  - 10.8.6 发展问题及前景

## 第十一章 2016-2020年中国集成电路产业发展分析

- 11.1 2016-2020年集成电路市场规模分析
  - 11.1.1 全球市场规模
  - 11.1.2 全球收入规模
  - 11.1.3 中国销售规模
  - 11.1.4 中国进口规模
  - 11.1.5 中国出口规模
- 11.2 2016-2020年中国集成电路市场竞争格局
  - 11.2.1 进入壁垒提高
  - 11.2.2 上游垄断加剧
  - 11.2.3 内部竞争激烈
- 11.3 提升集成电路产业核心竞争力方法
  - 11.3.1 提高扶持资金集中运用率
  - 11.3.2 制定融资投资制度

- 11.3.3 提高政府采购力度
- 11.3.4 建立技术中介服务制度
- 11.3.5 人才引进与人才培养
- 11.4 中国集成电路产业发展的问题及对策
  - 11.4.1 产业发展问题
  - 11.4.2 产业发展策略
  - 11.4.3 “十三五”发展建议
- 11.5 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析
  - 11.5.1 全球市场趋势
  - 11.5.2 国内行业趋势
  - 11.5.3 行业机遇分析
  - 11.5.4 行业发展预测

## 第十二章 2022-2028年中国芯片行业投资分析()

- 12.1 投资机遇及方向分析
  - 12.1.1 投资价值较高
  - 12.1.2 战略资金支持
  - 12.1.3 投资需求上升
  - 12.1.4 投资大周期开启
  - 12.1.5 大基金投资方向
- 12.2 行业投资分析
  - 12.2.1 投资研发加快
  - 12.2.2 融资动态分析
  - 12.2.3 阶段投资逻辑
  - 12.2.4 国有资本为重
- 12.3 行业并购分析
  - 12.3.1 全球产业并购规模
  - 12.3.2 全球产业并购动态
  - 12.3.3 国内并购动态分析
- 12.4 投资风险分析
  - 12.4.1 贸易政策风险
  - 12.4.2 贸易合作风险

- 12.4.3 宏观经济风险
- 12.4.4 技术研发风险
- 12.4.5 环保相关风险
- 12.4.6 产业结构性风险
- 12.5 融资策略分析
  - 12.5.1 项目包装融资
  - 12.5.2 高新技术融资
  - 12.5.3 BOT项目融资
  - 12.5.4 IFC国际融资
  - 12.5.5 专项资金融资

### 第十三章 中国芯片产业未来前景展望()

- 13.1 中国芯片市场发展机遇分析
  - 13.1.1 中国产业发展机遇分析
  - 13.1.2 国内市场变动带来机遇
  - 13.1.3 芯片产业未来发展趋势
- 13.2 中国芯片产业细分领域前景展望
  - 13.2.1 芯片材料
  - 13.2.2 芯片设计
  - 13.2.3 芯片制造
  - 13.2.4 芯片封测

部分图表目录：

图表：日本综合电机企业的半导体业务重组

图表：东芝公司半导体事业改革框架

图表：智能制造系统架构

图表：智能制造系统层级

图表：MES制造执行与反馈流程

图表：云平台体系架构

图表：《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标

图表：《中国集成电路产业“十三五”发展规划建议》发展目标

图表：2016-2020年国内生产总值及其增长速度

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202205/295133.html>